

嘉兴斯达半导体股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件

反馈意见回复（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年07月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211736号）（以下简称“《反馈意见》”）。

按照中国证监会的要求，公司已会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，并对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见2021年08月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于<嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见>之回复报告》。现根据中国证监会的进一步审核意见和要求，公司和相关中介机构对上述反馈回复的问题一的部分内容再次进行了补充、说明和修订，并根据规定对再次修订后的反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于<嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见>之回复报告（修订稿）》。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021年08月27日